





UcamX v2020.12



출시 개요

항상 한발 앞서서 ...

- DPMX 입력 
- YELO 회로 수정 기능 확장
- Text 일괄변경 
- SEC 에칭 보상 별 적용 
- 자동 마크 업 확장
- YELO 실크 조절기능 확장
- YELO 마스크 조절기 
- 그리고 더!

DPMX (IPC2581) 입력

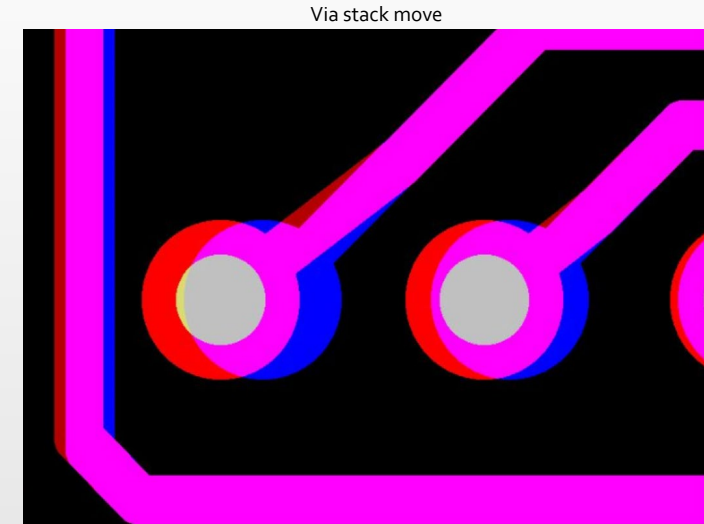
- IPC-DPMX 입력(이전의 IPC2581)에 대한 새로운 입력 옵션을 통해 데이터 포맷의 다양성을 유지하십시오.
- 수많은 커스텀 을 포함하고 가장 복잡한 인쇄 회로 기판을 제조해야 하는 대용량 파일도 원활하게 가져올 수 있습니다.
- 산업화된 입력 **새로운 Integ8ter 릴리스에도 포함됩니다.**

(새로운 옵션)

확장

- 새로운 자동 조정 : 패드 스택 이동을 통해. 해당 패드 스택과 함께 비아 홀을 **완전 자동으로 이동**하여 비아 홀 클리어런스 오류를 해결합니다.
- 멀티코어 PP + 에서 자동회로 프로세스를 약 30 %까지 가속화합니다.

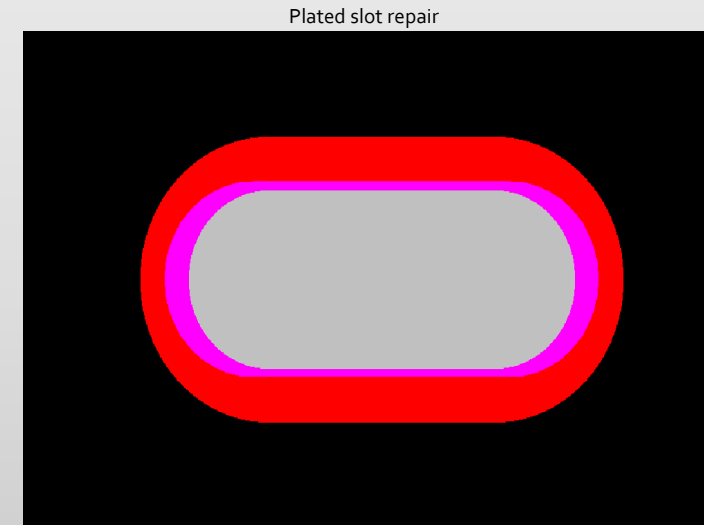
(기존 자동회로 조절 기능에 추가)



확장

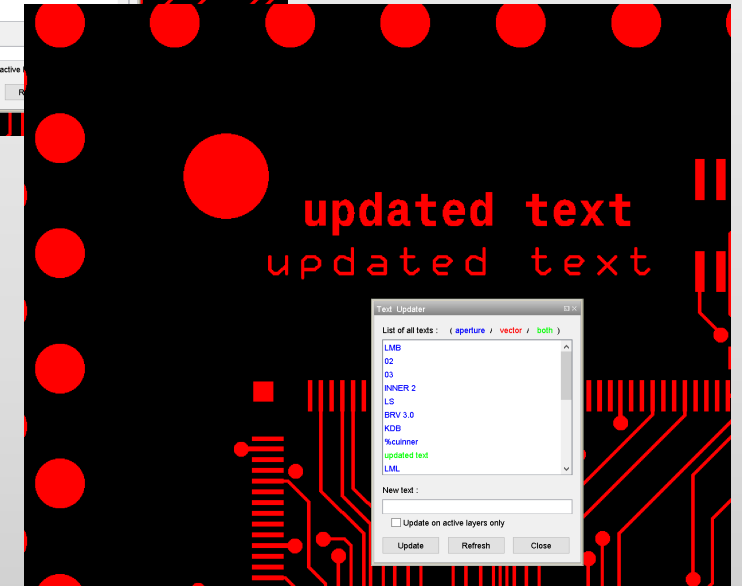
- 보드의 복잡성에 따라 **동일한** 넷의 (Net Spacing) 검사를 하나의 일반적인 임계 값 이상 포함된 세부 임계 값으로 실행할 수 있습니다. 관련 개체의 유형에 따라 서로 다른 임계 값을 사용할 수 있습니다.
- 새로운 자동 조정: **도금된 SLOT 에 대해 수리합니다.** 도금된 SLOT 에 대한 링 위반이 보고되고 **자동으로 수리**됩니다.

(기존 회로 조절 기능에 추가)



- 제품의 어디에 있더라도 벡터 텍스트와 플래시 텍스트를 모두 자동으로 모아서 보여주고 블록 내부의 텍스트까지 일괄 변경할 수 있습니다.

(무료 추가 기능)



안전 에칭보상

- 뿔 모양 보정으로 중요한 SMD 모서리의 언더 에칭 방지
- 자동 프로세스는 안전 에칭 보상 기능에서 구현됩니다.

(새로운 옵션)

Horns in Layout



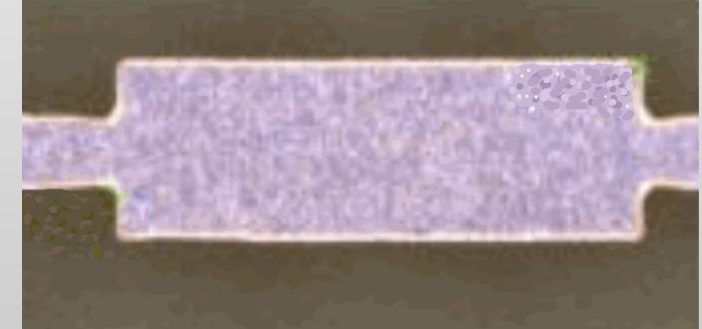
SMD with horns before etching



SMD after etching without horns



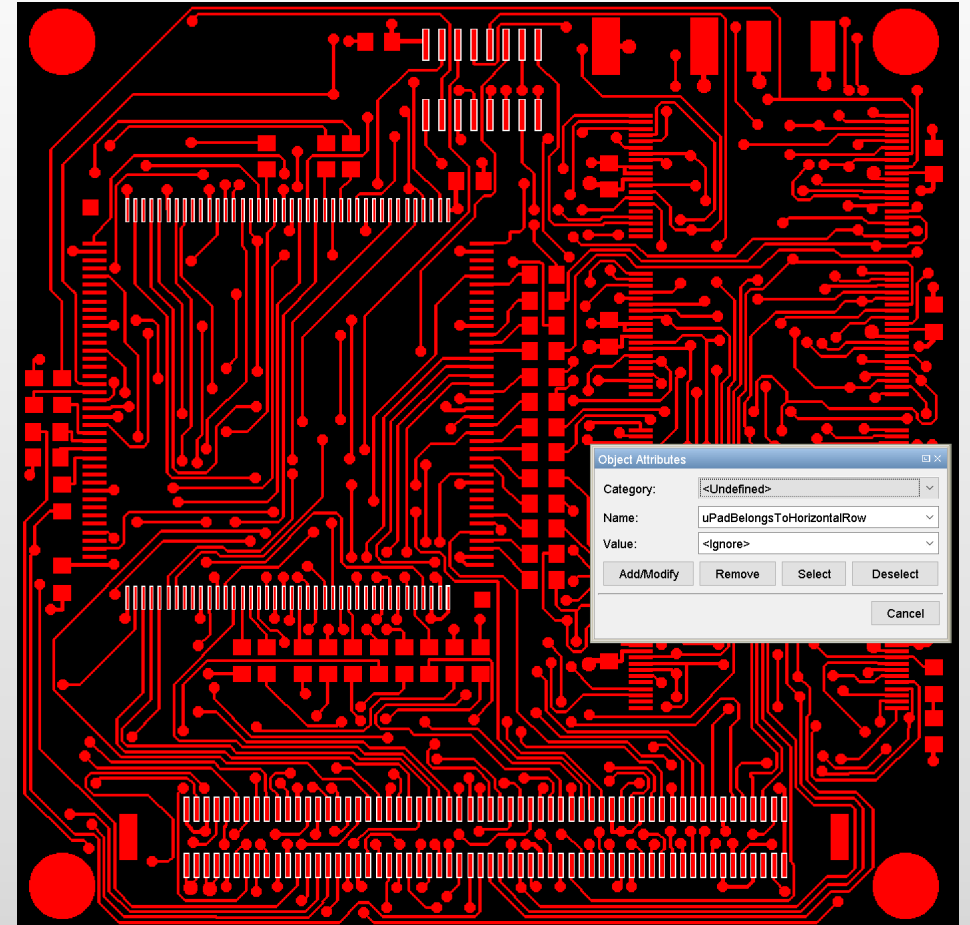
SMD after etching



확장

- 패턴의 패드에 대한 확장된 마크업 기능은 **복잡한 커스텀 아파추어**를 지원라고 **캠 작업 시간을 절약**해 줍니다.
- 피치가 특정 한계 값 미만인 SMD 패드의 행을 식별합니다. 이 새로운 기능은 패턴 패드의 마크업에서 추가되었으며 SMD 행의 **선택 프로세스를 단순화**합니다.

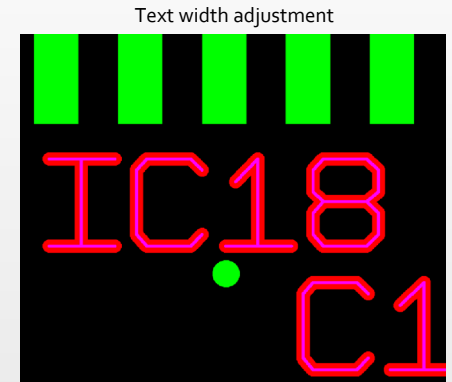
(기존 마크업 기능에 추가)



확장

- YELO의 자동화를 강화합니다.
- 자동 실크 라인 굵기 수정으로 수작업 시간이 줄어 듭니다.

(기존 실크 조절기에 추가)



(베타)

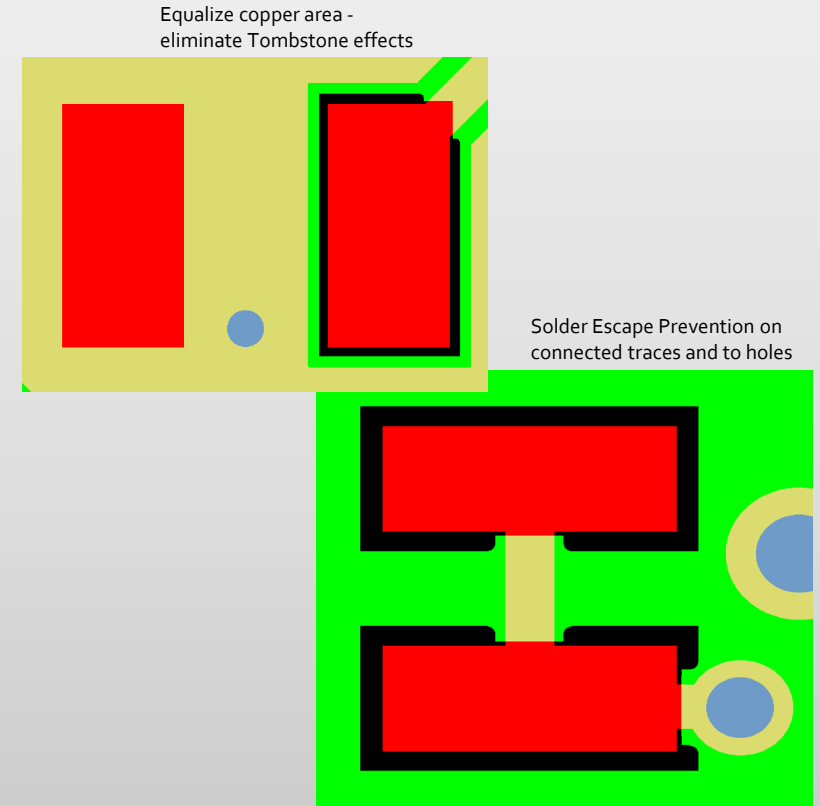
- 이제 베타 버전에서는 최종적으로 솔더마스크 최적화 도구를 업그레이드된 알고리즘으로 교체합니다.
- 테스트: 귀사의 지식과 요구 사항을 당사의 현재 개발 과정에 포함시키십시오.

(유지 관리 중인 고객 및 기존 솔더마스크 옵티마이저 라이선스를 통해 사용할 수 있습니다.)

툼 스톤 및 솔더 이탈 방지 (베타)

- 탁월한 툼 스톤 및 솔더 이탈 방지 기능을 포함하는 YELO 마스크 조절기
- 부품의 실장공정에서 가장 긍정적인 영향을 미치도록 마스크를 조정 하십시오.

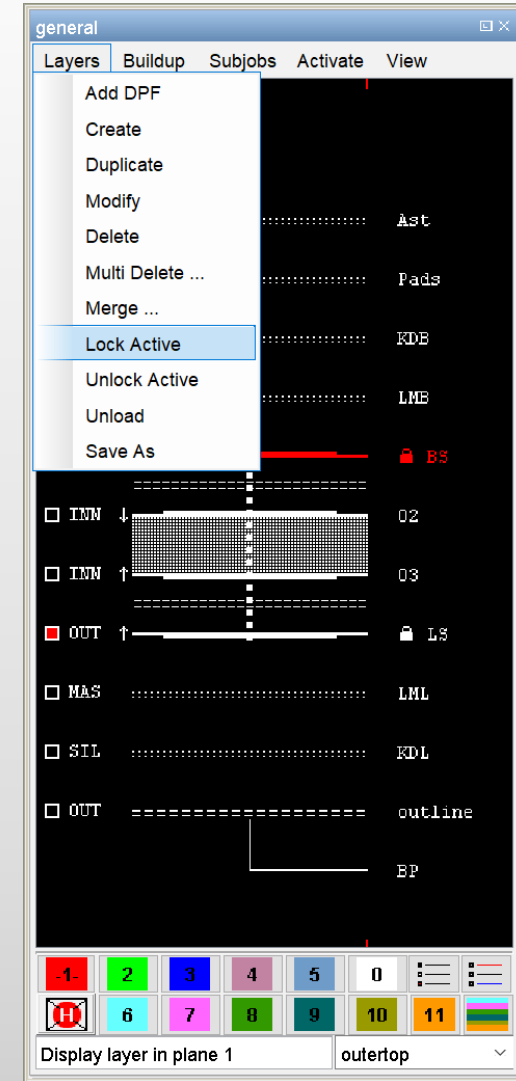
(새로운 옵션, 릴리스 v2020.12 에서만 베타 테스트를 위해 모든 사용자가 사용할 수 있음)



레이어 잠금

- 작업-> 저장 등을 사용할 때 저장되지 않도록 **보안이 강화**되었습니다. 예를들어 수치 값의 변경에 대한 시뮬레이션 작업에서...
- 작업 편집의 레이어 도구 모음 : **빠르고 쉬운 처리**를 위해 '활성 잠금' 및 '활성 잠금 해제'로 확장되었습니다.

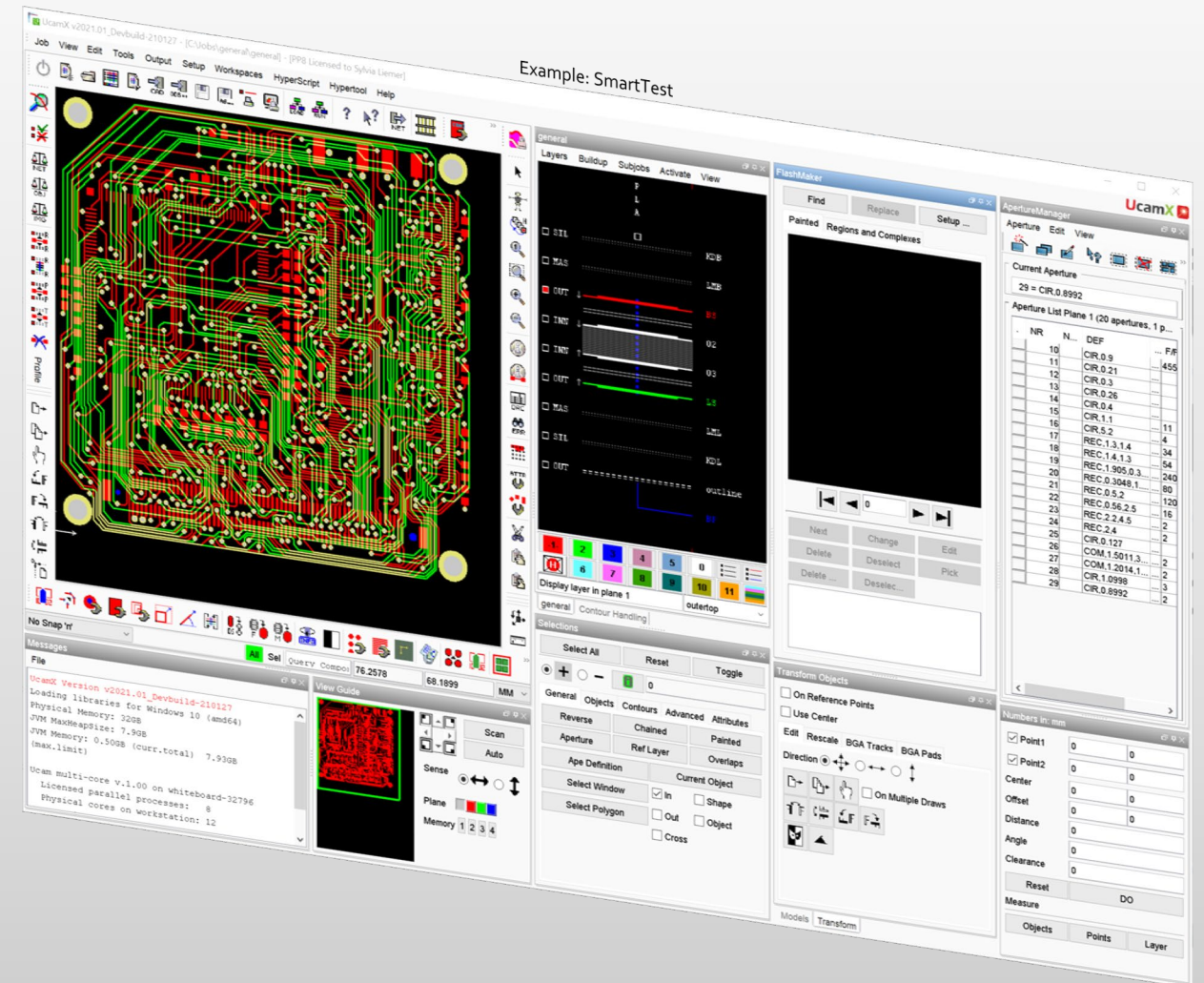
(기존 작업 편집기 기능에 추가 됩니다.)



작업 공간

- 스마트 제품 메뉴가 작업 공간 메뉴 옵션으로 확장되었습니다.
- 이러한 제품은 **최적화된 작업 공간**을 사용하여 작업을 완료할 수 있는 이점도 있습니다.

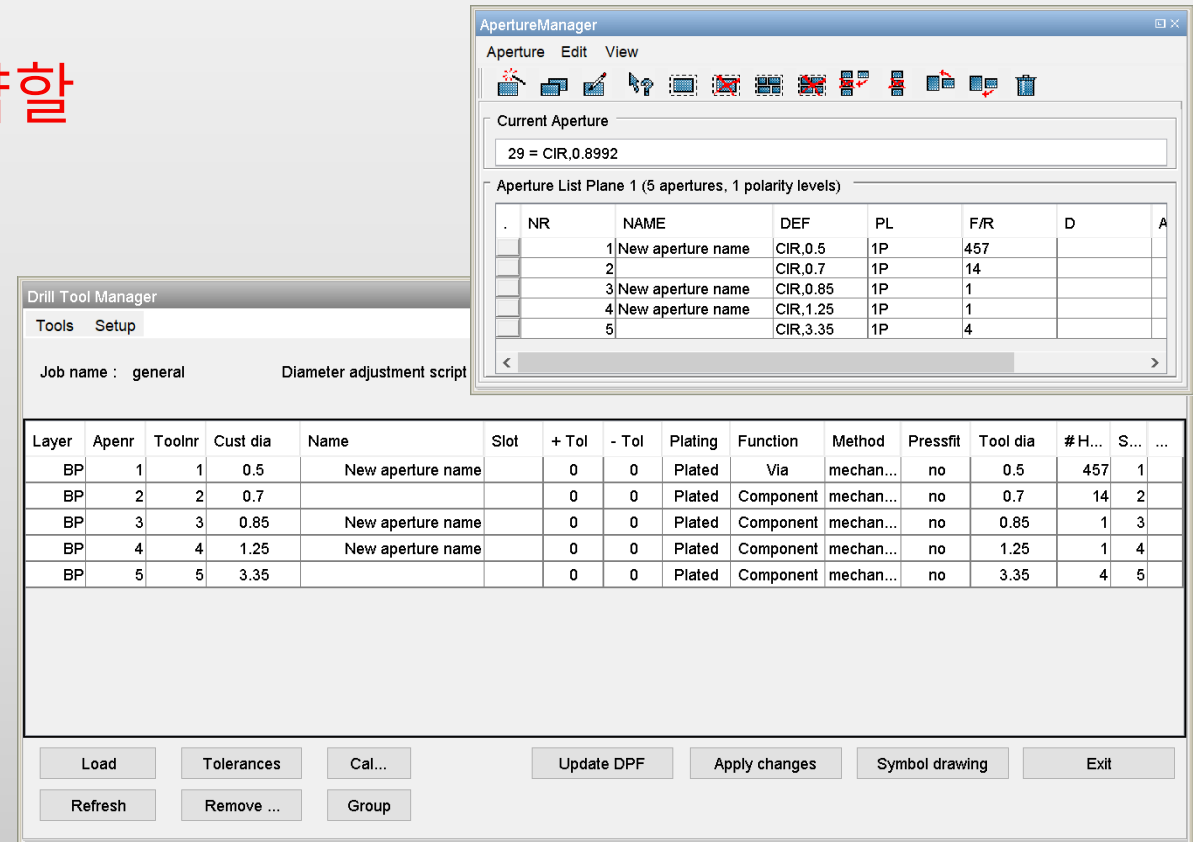
(기존 작업 영역 기능에 추가)



확장

- 수동으로 추가하지 않고 드릴 툴관리를 실행하는 동안 아파추어 이름을 직접 추가할 때 불필요한 작업 시간을 절약할 수 있습니다.

(기존 드릴 툴관리 기능에 추가)



The screenshot displays two windows from the Ucamco software. The 'Drill Tool Manager' window is in the foreground, showing a table of drill tool parameters and a list of apertures. The 'ApertureManager' window is in the background, showing a table of aperture parameters.

Drill Tool Manager Table:

Layer	Apenr	Toolnr	Cust dia	Name	Slot	+ Tol	- Tol	Plating	Function	Method	Pressfit	Tool dia	#H...	S...	...
BP	1	1	0.5	New aperture name		0	0	Plated	Via	mechan...	no	0.5	457	1	
BP	2	2	0.7			0	0	Plated	Component	mechan...	no	0.7	14	2	
BP	3	3	0.85	New aperture name		0	0	Plated	Component	mechan...	no	0.85	1	3	
BP	4	4	1.25	New aperture name		0	0	Plated	Component	mechan...	no	1.25	1	4	
BP	5	5	3.35			0	0	Plated	Component	mechan...	no	3.35	4	5	

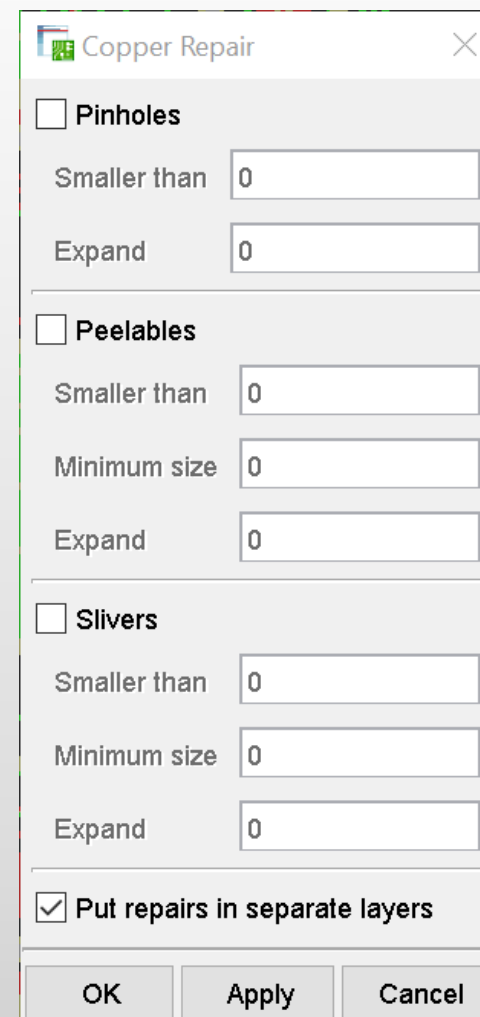
ApertureManager Table:

NR	NAME	DEF	PL	F/R	D	A
1	New aperture name	CIR,0.5	1P	457		
2		CIR,0.7	1P	14		
3	New aperture name	CIR,0.85	1P	1		
4	New aperture name	CIR,1.25	1P	1		
5		CIR,3.35	1P	4		

확장

- 자동 복원 영역을 사용자가 결정할 수 있게 되었습니다. 카파복원 기능의 새로운 옵션을 사용해 선택하세요.
 - 복원 레이어를 분리 하고자 할때 이 기능을 활성화하면 별도의 레이어에 복원 될 데이터가 형성됩니다.
 - 비활성화 시키면 현재의 레이어에 자동으로 복원 데이터가 추가 됩니다.

(기존 카파 복원 기능에 추가)



Copper Repair

Pinholes

Smaller than 0

Expand 0

Peelables

Smaller than 0

Minimum size 0

Expand 0

Slivers

Smaller than 0

Minimum size 0

Expand 0

Put repairs in separate layers

OK Apply Cancel

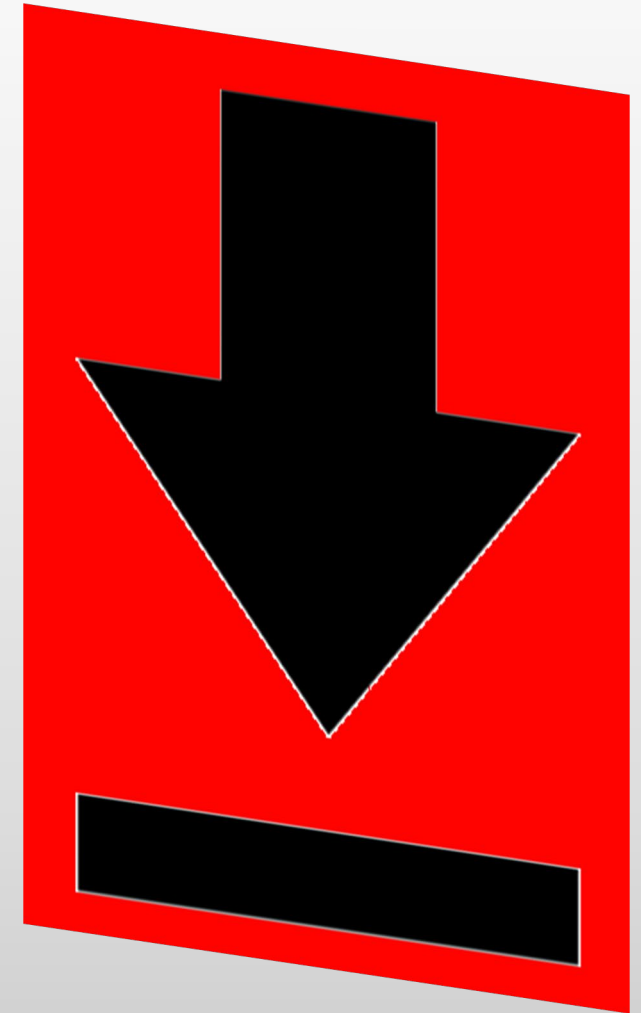
확장

- ODB 구조에 LPD 파일이 있는 경우 LPD 속성으로 **더 자세한 정보가 추가**됩니다.
- 음극성을 가진 레이어의 변환에 영향을 줄 수 있는 새로운 ucam.db 키 도입입니다. 극성이 **요구 사항에 맞게** 변환된 ODB++ 데이터를 가져옵니다.

(기존 ODB++ 입력 기능에 추가)



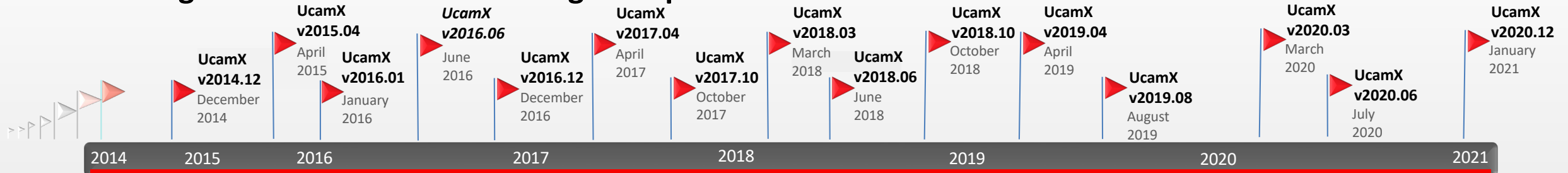
- 설치 프로그램은 Ucamco FTP 다운로드 서버에서 다운로드할 수 있습니다. 대부분의 인터넷 브라우저가 FTP 다운로드 지원을 중지했으므로 FTP 클라이언트를 사용하는 것이 좋습니다.
- 가능한 한 빨리 이 업데이트를 설치하는 것이 좋습니다.
- 추가 질문이 있으시면 당사의 현지 비즈니스 파트너 또는 Ucamco 헬프데스크에 문의하십시오.
- Ucamco 제품을 선택해 주셔서 감사합니다.



Already looking ahead



Serving our customer base with regular updates



Version	Release date	Highlights
2014.12	Dec-14	Workspace GUI, Parallel processing
2015.04	Apr-15	Load balanced sessions, Gerber X2 Input support
2016.01	Jan-16	Background output, Parallelized image compare
2016.06	Jun-16	Maintenance update
2016.12	Dec-16	New insert Arc command, Improved Sieb&Meyer rout import
2017.04	Apr-17	Performance boost DRC copper-cut-ins, Improved "Select Painted" feature
2017.10	Oct-17	New startup routine, Extended Job Editor View, Optimized Rout Compensation
2018.03	Mar-18	Eagle input with proportional font, Scaled line width in Silk optimizer, Introduction of YELO Signal Layer Adjuster
2018.06	Jun-18	Save jobs by creating archives, free trial period of all YELO modules
2018.10	Nov-18	Query Component, Read Component information from ODB++
2019.04	Apr-19	YELO Combined GUI for all copper layers, New YELO functionality, Rout Manager enhancements
2019.08	Aug-19	Keyboard Shortcuts, Plane Focus Indicator, Maintenance update
2020.03	Mar-20	Upgraded to Java 11, New Select Painted algorithm, New YELO functionality, Gerber X3 input (component information)
2020.06	Jul-20	Verification of unique combination of subclass, attach and index number
2020.12	Jan-21	DPMX Import, Text Changer, Line width adjustment in YELO Legend Adjuster, Via pad stack move in YELO Copper Adjuster

▲ Today

© Copyright 2021 Ucamco NV, Gent, Belgium. All rights reserved.

This material, information and instructions for use contained herein are the property of Ucamco NV. The material, information and instructions are provided on an AS IS basis without warranty of any kind.

Ucamco NV does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use, or the results of the use of the software or the information contained herein.

Ucamco NV shall not be liable for any direct, indirect, consequential or incidental damages arising out of the use or inability to use the software or the information contained herein.

The information contained herein is subject to change without prior notice.

Revisions may be issued from time to time to advise of such changes and/or additions.

No part of this presentation may be reproduced, stored in a data base or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from Ucamco NV.